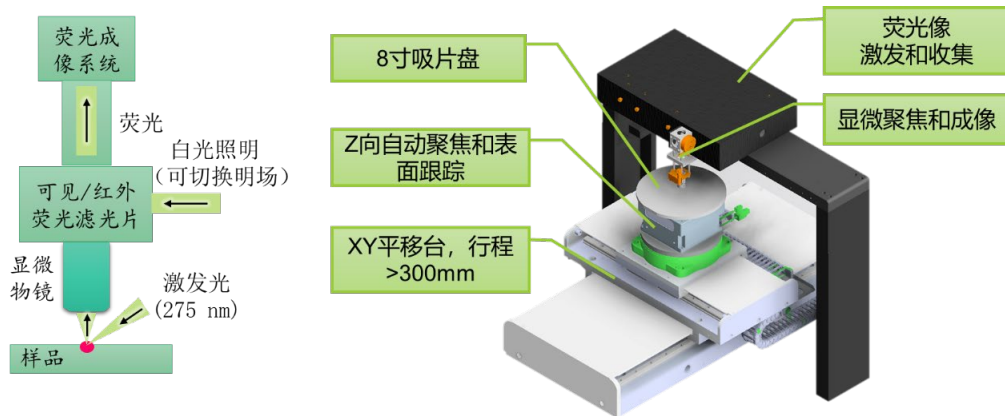


宽场荧光显微成像模组

Wide-field Fluorescence Microscope Module

- 以自动化显微镜模组为基础，针对 SiC 等化合物半导体晶圆位错、层错等缺陷检测需求。
- 无须化学腐蚀、解理等样品前处理工艺，非接触、无损、整晶圆检测。



产品特性和核心技术:

激光自动聚焦。

- 自主研发的激光辅助离焦量传感器。
- 可在紫外激发光照射样品并采集荧光信号的同时工作，实现自动聚焦和表面跟踪。

紫外暗场照明。

- 标配波长 275 nm 紫外激发光，可按用户要求定制其它波长激发光。
- 可同位采集明场显微像、可见光波段暗场荧光像、红外波段暗场荧光像，分析样品中位错、层错等晶格缺陷的分布。

全自动操作。

- 自动化的控制软件 and 数据处理软件，全软件操作。

相关国家标准:

- 《中华人民共和国国家标准 GB_T 43493.3-2023 半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第3部分：缺陷的光致发光检测方法》（2023年12月28日发布，2024年7月1日实施）

Zolix
卓立汉光

北京卓立汉光仪器有限公司成立二十五周年

25th
逐光而行 将致致远
Lighting Steps to Future

TEO
先锋科技
Titan Electro-Optics

3大板块产品

光谱与影像产品

工业光电与精密机械

激光与测量产品



关注了解更多



知名光电产品集成商



一键触达光电臻品

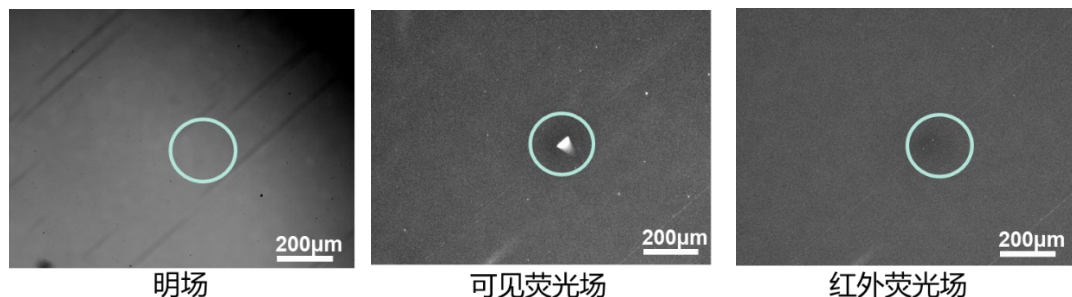
性能参数:

荧光激发和收集模块	激发波长	275 nm
	自动对焦	在全扫描范围自动聚焦和实时表面跟踪。 对焦精度<0.2 微米。
	显微镜	2x, 5x ,10x, 50x, 100x 物镜可选。 空间分辨率: 10x 物镜< 2 μm, 100x 物镜< 0.5 μm。
	荧光波长范围	可见: 400-700nm 红外: 685-1100nm
	荧光像视场	2x 物镜: 8×8 mm; 10x 物镜: 1.6×1.6 mm; 100x 物镜: 0.16×0.16 mm。
样品移动和扫描平台	平移台	扫描范围大于 300×300 mm。
	样品台	8 寸吸气台 (12 寸可定制) , 可兼容 2、4、6、8 寸晶圆片。
软件	控制软件	可选择区域或指定点位进行明场和暗场荧光像的自动采集和存储。
	数据分析	识别晶体中的沾污、划痕、微管、腐蚀坑类型、基面位错、堆积层错等

应用案例:

6 英寸 SiC 外延片缺陷检测

堆叠层错 (SF)



基面位错 (BPD)

